

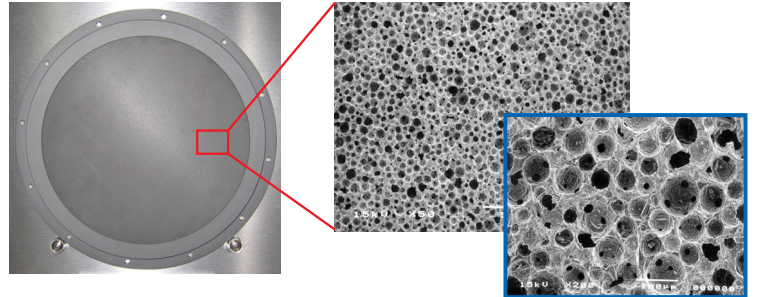
# “CERASIC-BP” 多孔質SiC Porous SiC

“CERASIC-BP”は3次元網目構造を持ち、気孔率50～80%の範囲で制御可能な多孔質SiCです。また、当社独自の接合技術によりCERASIC（緻密質SiC）との接合が可能で、複合材料としての用途にも使用可能です。

“CERASIC-BP” is a porous SiC with a 3-dimensional mesh structure, controlling its porosity range of 50% to 80%. In addition, it can be bonded with standard CERASIC (non-porous), enabling other applications as a composite material as well.

- 最大形状:プレート 330×10mm •Max Size Availability : plate 330 x 10 mm
- 気孔率範囲 : 50～80% •Porosity range : 50 to 80%

CERASIC-BP (気孔率60%) CERASIC-BP (Porosity 60%)



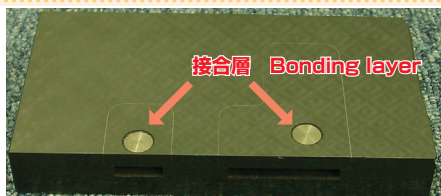
	CERASIC-BP			CERASIC	
	AP50	AP60	AP80	0.1以下	0.1 or less
Bulk density (g/cm <sup>3</sup> )	1.60	1.20	0.65	3.15	
Bending strength (MPa)	80	50	10	450	
Thermal conductivity (W/mk)	25°C	74	43	170	
	200°C	51	30.	130	
Coefficient Thermal expansion (10 <sup>-6</sup> /°C)	-50°C	1.9	-	1.8	
	25°C	2.2	-	2.3	
	100°C	2.5	-	2.5	

## CERASICの接合技術 CERASIC Bonding Technology

“CERASIC”は当社独自の接合技術により、中空構造や複雑構造への適用が可能です。このことにより、製品のさらなる軽量化、複雑形状化を実現しました。また、“CERASIC-BP”（多孔質SiC）との接合も可能で、あらゆる

“CERASIC” can be adapted for complicated or hollow structure bodies with our unique bonding technology, and it achieves further miniaturization and complicated dimensions. Furthermore, “CERASIC” can be bonded to “CERASIC-BP” which expands its application range.

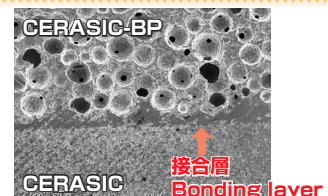
- 接合可能寸法 : 1200mm •Sealable dimensions : 1200mm
- 接合部曲げ強さ : 200MPa (25°C) •Seal bending strength : 200MPa (25°C)



中空構造体モデル  
Hollow Structural Model



CERASICどおしの接合  
CERASIC/CERASIC



CERASICとCERASIC-BP(多孔質)との接合  
CERASIC/CERASIC-BP

**COVALENT**

コバレントマテリアル株式会社